

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年年度业绩说明会的投资者
时间	2024年03月27日 15:00-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 丁国兴 董事、总经理 赵奇 财务负责人、董事会秘书 王韦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 领导您好，请问未来在工控领域的规划如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，在工业控制领域，公司将全面推进风光储网算5个方向产品布局和市场渗透。（1）AI服务器、数据中心等应用方向：高效率电源管理芯片日益显现为AI和大型数据中心的核心技术。公司将在已经发布面向数据中心服务器的55nm高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点的基础上，全面推动产品导入和市场渗透。（2）风光储充应用方向：公司将为全球风光储充头部企业提供高功率、高可靠性、高稳定性的功率半导体IGBT、SiC芯片及模块；大功率工商业、地面光伏、储能扩大市场占有；全面导入风电客户。（3）智能电网方向：2023年作为特高压直流输电的核心器件超高压IGBT产品已在多地挂网使用，2024年公司将展开新一代产品研发，全面支持双碳目标下的特高压直流智能电网高速建设。感谢您的关注。</p>

2. 公司计划从新能源向AI领域延伸的主要布局是？如何打造汽车智能化高效电源化产品？

答:尊敬的投资者您好，2023年公司在AI服务器、数据中心等应用方向发布了面向数据中心服务器的55纳米高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点。

2024年，公司未来将聚焦在新能源和AI两大方向。新能源方向的应用领域主要覆盖新能源汽车和风光储市场；AI方向应用领域主要覆盖电源管理和机器人市场。未来公司将重点加强AI领域的技术布局和市场拓展，汽车智能化、高效电源管理芯片的产品导入和市场渗透，以及推进智能传感器芯片在机器人领域的应用。在AI服务器、数据中心等应用方向，高效率电源管理芯片日益显现为AI和大型数据中心的核心技术。公司将在已经发布面向数据中心服务器的55nm高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点的基础上，全面推动产品导入和市场渗透。

另外，公司将进一步完善消费终端布局，完整覆盖四大消费终端：手机，智能穿戴，笔电以及家电，尤其AI在消费终端的兴起，给半导体在消费电子领域提出更多技术需求：包括强大的处理能力、低功耗、高集成度、安全性和可靠性等，也为半导体在消费电子领域带来巨大的机遇。公司会进一步加大相关产品的研发投入，加速产品开发速度，预计2024年有多个AI相关产品技术平台发布，全面支持AI加持的消费终端。

感谢您的关注。

3. 贵司现在产能利用率已经很高，请问何时能毛利转正，毛利转正是否维持现有产能，通过折旧减少的方式来提高毛利还是其他方式，比如继续扩产？提高单价？

答:尊敬的投资者您好。2023年公司经过艰苦奋斗在新技术和新市场上实现突破，成功推出了新产品，获得了多个重大客户定点。这些新产品的全面客户导入和大规模上量，将为2024年和2025年公司重新回到高速度增长提供强大动力和坚定信心。公司在第二增长曲线SiC和第三增长曲线BCD的产能将根据技术产品的推进进度、市场需求的情况，适时进行扩产。

降本减亏方面，第一，不断通过技术迭代、技术创新实现技术的领先性和丰富化，在此基础上实现更大的生产规模，贡献更大的营收。通过产品的技术迭代，全球领先的新一代IGBT器件会在24年下半年量产，大幅提高单位晶圆片的芯片产出数量，实现营收的增长；通过SiC芯片和模组、BCD、VCSEL等实现新技术、新产品上量营收增长；积极扩大市场份额，增加公司的营收来摊薄成本。第二，不断优化公司成本结构，通过工艺步骤、工艺条件的优化降低工艺平台的基础成本，通过生产效

率的不断提升摊薄和降低单步工艺的成本。通过供应链的战略合作、协同、公平竞争降低材料和零部件的采购成本。通过公司精细化管理、信息数据流程系统化、设备自动化等提高人员工作效率、降低库存对资金的占用等。

通过以上的措施，公司2024年亏损将大幅降低。感谢您对公司的关注。

4. 目前公司污水处理厂的处理能力如何？区域布局情况呢？

答:尊敬的投资者您好，公司产生的废水根据污染物类型配套建设相应的处理系统，主要包括：含氟废水处理系统、含氨废水处理系统、研磨废水处理系统、重金属废水处理系统、酸碱综合废水系统等，各系统建设符合环评批复规定的处理工艺及能力。生产废水经处理后达标排放，满足《污水综合排放标准》、《电子工业水污染物排放标准》等法规要求。经厂区总排口进入绍兴市柯桥污水处理厂后统一处理。感谢您的关注。

5. 请问贵司车规级工艺平台收入占比是多高？另外车规级工艺的研发投入占所有研发费用的比重是多少？

答:尊敬的投资者您好，2023年公司获益于国内新能源汽车行业的快速增长及国产替代的双重红利。从下游应用领域来分，公司46.97%的主营收入来自车载应用领域，同比增长128.42%。车载应用领域系公司业务发展的重点方向，因此研发投入占比也较高。感谢您的关注。

6. 赵总，您好。根据小米汽车的参数，电池是用的宁德时代800V碳化硅高压平台，而宁德时代又是贵司芯联动力的参股股东。请问小米汽车上的碳化硅芯片，是不是最终由贵司代工的？

答:尊敬的投资者您好！公司作为集成电路制造一站式系统代工平台，客户信息按照客户的要求需要保密，因此公司客户信息涉及商业秘密，不便披露。感谢您对公司的关注！

7. 领导能分享下公司未来业务运营规划吗？

答:尊敬的投资者您好，随着公司业务模式和技术方向的不断扩展，公司的发展已经迈入了转型发展的新阶段。公司发展主要为三条曲线：第一条重大主线为硅基功率半导体，第二条增长主线是碳化硅相关业务，同时布局基于BCD平台的第三增长曲线。从公司定位来看，公司从提供设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证、可靠性测试一站式代工能力，到目前已开始具备系统方案的能力，公司的定位从代工企业向一站式系统芯片解决方案的供应商转型。

从产品结构来看，不断丰富产品线，公司产品线由原来的IGBT、MOSFET、MEMS、功率模组扩展到模拟IC、BCD、SiC MOS、VCSEL，同时研发MCU。从应用领域来看，公司未来将聚焦在新能源和AI两大方向。新能源方向的应用领域主要覆盖新能源汽车和风光储市场；AI方向应用领域主要覆盖电源管理和机器人市场。未来公

司将重点加强AI领域的技术布局和市场拓展，汽车智能化、高效电源管理芯片的产品导入和市场渗透，以及推进智能传感器芯片在机器人领域的应用。

具体的经营计划请详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》第三季 管理层讨论与分析 之六、公司关于未来的讨论与分析。感谢您的关注。

8. 请问贵公司的折旧率这么高是什么造成的

答:尊敬的投资者您好，公司属于资金密集型及技术密集型半导体行业，需要大额的固定资产投入及持续的研发投入以保持产品的技术领先。同时，公司的主要生产设备采用5-10年快速的折旧方法，系公司依据行业惯例、设备状态作出的合理会计估计。公司目前尚处于折旧高峰期，随着时间的推移，折旧将逐步消化。感谢您的关注。

9. 您好，丁董。绍兴市人民政府官网发布的：“芯联集成电路制造股份有限公司以碳化硅为代表的产品科技高、性能好，产品供应比亚迪、蔚来、小鹏、理想等发展势头良好的新能源车企，是当之无愧的用电大户，企业今年1~2月用电量为8733万千瓦时，同比增长28.8%，在高基数上实现中快增长。”请问，用电量增长28.8%，是否预示贵司今年一季度订单量也大幅增长，营业收入也会实现大幅增长？因为用电量是最可靠的工业指标。

答:尊敬的投资者您好，公司2023年8英寸硅基晶圆生产量156万片、6英寸SiC MOS生产量2.8万片，12英寸硅基晶圆生产量近1万片，同比增长约23%，主营业务收入也相应增长。目前公司产能利用率逐步提升，预计营收将实现同步增长。感谢您的关注。

10. 您好，丁董。从公开的信息看，贵司的技术是非常领先的，市场认可度也很高，盈利端受制于折旧、研发费用占营业收入的占比太高，而营业收入增长又受制于产能需逐步释放。请问贵司2024年-2026年的产能规划，每年会新释放多少产能，营业收入每年有多大提升空间？另外折旧，从那一年开始会开始减少？

答:尊敬的投资者您好，公司已建设有月产17万片的8英寸硅基晶圆产线、月产5000片的6英寸SiC MOS晶圆产线，月产1万片的12英寸硅基晶圆中试线。

目前，公司8英寸SiC MOS晶圆和芯片研发进展顺利，预计年内送样，明年量产；和新能源战略客户共同开拓SiC MOS在车以外的重大新应用上的开拓，扩大SiC MOS的应用范围。在12英寸硅基晶圆方面，公司BCD技术平台已经过两代技术的更新，第一代产品已经开始小规模量产，第二代55nm解决方案具有非常有竞争力的效率，已获得关键客户定点，未来公司将扩大客户群、加速产品导入。随着公司在SiC MOS产线、12英寸产线、模组产线的快速释放，收入将迅速提升，随着折旧的逐步消化，公司在规模效应、技术领先性以及产品结构等方向的差异化优势将逐渐显现，

将快速改善公司的盈利能力。感谢您的关注。

11. 您好，王总。国家为了支持半导体行业的发展，对半导体行业出台了折旧政策。请问半导体行业的折旧政策，相比常规的折旧政策，对半导体企业有哪些好处？折旧期内和出折旧期，对半导体企业利润情况有何影响？

答:尊敬的投资者您好，公司的主要生产设备折旧年限为5-10年，折旧对公司报告期内的经营业绩产生了较大影响。剔除折旧及摊销等因素的影响，公司2023年EBITDA（息税折旧摊销前利润）为9.25亿元，同比增长约14.29%。随着新增产能的逐步释放，收入水平的快速提升，规模效应逐步显现，以及折旧的逐步消化，公司在业务布局、技术的领先性以及产品结构等方向的优势将逐渐显现，盈利能力将得到快速改善。感谢您的关注。

12. 贵司是2018年成立的，请问贵司主要生产设备的折旧期是几年？实际使用寿命，大约是多少年？

答:尊敬的投资者您好，公司的主要生产设备折旧期为5-10年。由于公司的主要生产设备均置于恒温、恒湿等环境中，参考行业内同类公司的情况，实际使用寿命通常会长于折旧期。感谢您的关注。

13. 2023年公司营收的46.97%来自车载应用领域，未来是否还会继续扩大布局

答:尊敬的投资者您好，公司产品的主要应用方向为车载、工控与消费，随着汽车的智能化和电动化，车载产品的应用方向将不断延伸和拓展。在电动化方面，公司在功率半导体特别是先进SiC MOS芯片及模块进一步扩大市场份额。通过技术创新加精益经营，为市场带来更具性价比的产品。公司将在车载模拟IC领域推出多个国内领先和全球先进的技术平台，填补国内高压大功率数字模拟混合信号集成IC的空白，进一步推动汽车电源管理和智能控制的全栈解决方案。在智能化方面，公司激光雷达核心芯片将全面扩展客户和市场渗透，快速提高市占率。多个传感器项目包括高精度惯性导航传感器、压力传感器、高性能车载麦克风将进入智能汽车终端，全面助力汽车智能化的发展。感谢您的关注。

14. 贵司在2023比亚迪核心供应商大会，荣获比亚迪颁发的“特别贡献奖”。请问，贵司是在哪些芯片技术上取得突破，或者说是在哪些方面为比亚迪带来了较大的价值，所以比亚迪给颁发了“特别贡献奖”。

答:尊敬的投资者您好，公司的产品成功进入了新能源汽车的主驱逆变器、车载充电器、DC/DC系统、辅助系统等核心应用领域。感谢您的关注。

15. 芯联动力的参股股东包括宁德时代下属的宁德晨道投资，另外还有阳光电源。请问贵司和宁德时代、阳光电源等新能源电池企业，在哪些芯片上有合作？

答:尊敬的投资者您好！公司作为集成电路制造一站式系统代工平台，客户信息按照客户的要求需要保密，因此公司客户信息涉及商业秘密，不便披露。感谢您对公司的关注！

16. 瑞银等外资流通股是他们通过二级市场购买的吗？

答:尊敬的投资者您好，是通过二级市场购买。感谢您的关注。

17. 今年一季度季报预计什么时候披露？

答:尊敬的投资者您好，公司一季报预计于4月下旬披露。感谢您的关注。

18. 领导好，公司建设的8英寸碳化硅（SiC）器件研发产线目前进展如何？

答:尊敬的投资者您好，目前该产线正按计划顺利推进中，预计2024年年内通线。感谢您的关注。

19. 贵司招股说明书上说，预计2026年盈利。目前贵司在汽车芯片，SIC（碳化硅）芯片，以及风光储充芯片，电网芯片上，目前技术上已取得绝对领先的优势。请问，2026年盈利的这一预期，有没有可能会提前到2025年盈利。

答:尊敬的投资者您好，2023年公司在8英寸IGBT等功率器件、HVIC（BCD）等功率驱动、MEMS传感信号链等核心芯片及模组的产品方向上，持续增加研发投入，不断迭代出具有国际竞争力的产品；在SiC产线、12英寸硅基晶圆产线、模组产线等方面做了详实的战略规划和项目布局，进行了大量的先进设备等资产投入及新产品研发投入。随着新建产能的快速释放，收入的迅速提升，以及折旧的逐步消化，公司在规模效应、技术领先性以及产品结构等方向的差异化优势将逐渐显现，将快速改善公司的盈利能力。感谢您的关注。

20. 你好，芯联集成的股价破发已半年多，请问，今年5月10日解禁32.9616亿股，是否有延期解禁？

答:尊敬的投资者您好，公司目前暂未收到股东关于延长锁定期的计划。感谢您的关注。

21. 公司业务是否与中芯国际产品重复呢？是否是竞争关系。

答:尊敬的投资者您好，目前芯联集成与中芯国际没有正面竞争。未来根据客户的需求，各自独立开展相关的业务。感谢您的关注。

22. 梁孟松与咱公司有什么关系吗？

答:尊敬的投资者您好，梁孟松先生与芯联集成没有关系。感谢您的关注。

23. 贵司说：“长期来看，公司碳化硅（SiC）业务有望在全球达到30%的市场占有率”。另外Yole发布的2023年版《功率碳化硅报告》，预计到2028年，全球功率碳化硅器件市场将增长至近90亿美元。仅凭碳化硅业务这一项，贵司就能达到27亿美元（近200亿元）营收？不可否认，贵司已经在碳化硅业务上取得了先机，站在了全球第一梯队。请问，加上其他方面业务，贵司5年内的营收目标，大概是多少？

答:尊敬的投资者您好，公司从2021年起投入SiC MOSFET芯片、模组封装技术的研发和产能建设，两年时间完成了3轮技术迭代，完成了应用于主驱的平面SiC MOSFET技术的突破。目前，公司最新一代的SiC MOSFET产品性能已达世界领先水平，用于车载主驱逆变器的SiC MOSFET器件和模块也于2023年实现量产。截至2023

年12月，公司6英寸SiC MOSFET产线已实现月产出5000片以上，2024年公司还将计划建成国内首条8英寸SiC MOSFET试验线。公司已与多家头部车企进行合作，未来将继续拓展更多新能源汽车主机厂和零部件客户。随着产品验证的推进和产能的不断提升，SiC MOSFET产品上车数量将迅速提升，营业收入也将大幅增长，继续巩固公司在国内车规级芯片代工与模组封测领域的领先地位。感谢您的关注。

24. 请问公司今年的利润分配方案/分红情况如何？

答:尊敬的投资者您好，公司2023年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。感谢您的关注。

25. 请问公司中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目进展情况如何？预计完工时间？

答:尊敬的投资者您好，公司子公司芯联先锋承接并实施公司三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目。12英寸产线的产品广泛应用于新能源(风光储能等)、汽车、工控、消费等各个应用领域。在产线和产能建设方面，2023年公司完成了中试线项目机台的安装调试和工艺通线，并完成了月产1万片的设计产能，目前其IGBT、SJ、HVIC、BCD等各个平台均已进入规模量产阶段，处于产量爬坡中。感谢您的关注。

26. 请问，领导。问界M9纯电版、M7纯电版电池是用的宁德时代800V碳化硅高压平台，而宁德时代又是贵司芯联动力的参股股东。请问问界系列汽车上的碳化硅芯片，是不是最终由贵司代工的？

答:尊敬的投资者您好！公司作为集成电路制造一站式系统代工平台，客户信息按照客户的要求需要保密，因此公司客户信息涉及商业秘密，不便披露。感谢您对公司的关注！

27. 在AI人工智能，AI服务器，算力，数据中心等未来有巨大潜力的应用方向，贵司都做了哪些规划和储备，可以代工和生产哪些芯片。

答:尊敬的投资者您好，2023年公司在AI服务器、数据中心等应用方向发布了面向数据中心服务器的55纳米高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点。2024年，公司未来将聚焦在新能源和AI两大方向。新能源方向的应用领域主要覆盖新能源汽车和风光储市场；AI方向应用领域主要覆盖电源管理和机器人市场。未来公司将进一步加强AI领域的技术布局和市场拓展，汽车智能化、高效电源管理芯片的产品导入和市场渗透，以及推进智能传感器芯片在机器人领域的应用。在AI服务器、数据中心等应用方向，高效率电源管理芯片日益显现为AI和大型数据中心的核心技术。公司将在已经发布面向数据中心服务器的55nm高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点的基础上，全面推动产品导入和市场渗透。

另外，公司将进一步完善消费终端布局，完整覆盖四大消费终端：手机，智能

穿戴，笔电以及家电，尤其AI在消费终端的兴起，给半导体在消费电子领域提出更多技术需求：包括强大的处理能力、低功耗、高集成度、安全性和可靠性等，也为半导体在消费电子领域带来巨大的机遇。感谢您的关注。

28. 贵公司产品主要还是以内销为主，未来是否有扩大外销布局计划？

答:尊敬的投资者您好，公司2023年主营业务收入中，外销收入5.61亿元，占比超10%。2023年度外销收入同比增长42.58%，公司的技术先进性和质量稳定性也得到了海外客户的充分认可。公司将通过合适的市场渠道进行海外生态的广泛拓展，以支持海外销售的快速增长。感谢您的关注。

29. 请问贵司对未来三年（2024年-2026年）有没有做相应的规划，这三年的产能目标分别是达到多少？另外这三年的营业收入目标分别是多少？

答:尊敬的投资者您好，公司的发展战略、经营计划等详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》第三季 管理层讨论与分析 之六、公司关于未来的讨论与分析。感谢您的关注。

30. 贵司应用于光伏行业的芯片，2023年的营收大概是多少？增长情况如何？

答:尊敬的投资者您好，公司2023年主营收入中，29.46%来自工控应用领域（主要包括光伏、风电、储能、充电等领域），同比增长26.63%。感谢您的关注。

31. 领导您好，请问公司对ESG治理持怎样的看法？未来将如何响应？

答:尊敬的投资者，您好！公司坚持推进可持续发展，促进多元包容，积极履行社会责任，将ESG治理充分融入公司的战略、创新和运营之中，并取得显著进展。公司将持续关注国家政策和行业标准，不断完善公司治理结构，吸取优秀同行的ESG管理经验，努力提升ESG治理水平。2024年3月26日，公司已于上海证券交易所网站披露公司《芯联集成电路制造股份有限公司2023年企业社会责任报告》。感谢您对公司的关注！

32. 贵司在年报上说，要增加与投资者交流，及时回复投资者的提问。可是贵司从1月3号，到现在将近3个月时间里，只回复了8个提问。希望贵司未来能及时回复投资者的提问，以能及时回应投资者的关切。

答:尊敬的投资者，您好！感谢您的意见及建议。我们重视每位投资者的提问，并及时回复，努力做好投资者的沟通与交流工作，回应投资者的关切。感谢您对公司的关注。

33. 美国欧洲等收紧电动汽车进口政策，对贵公司可有影响？

答:尊敬的投资者您好，汽车是万亿级的大赛道，车用电子市场快速增长，目前公司正处于高速增长阶段。公司已布局汽车电动化和智能化应用方向的核心芯片和模组。在电动化方面，公司更高性能的SiC MOS器件开发顺利，迭代速度进一步加快；车规级主驱控制芯片在国内外广泛取得重大定点，在市场上卡住了关键站位。在智能座舱和自动驾驶方面，公司已经准备了从激光雷达、惯性导航、智能音频控

	<p>制等多个先进关键芯片制造技术，并已获得多个关键客户。在车身末端智能控制芯片上，公司已向市场提供集成化的芯片制造和IP平台，填补了国内空白。 总之，在汽车电子方面，公司将大面积拓展产品线、提升市场占有率，相信未来几年仍将保持快速增长。对于欧美对电动车的进口政策，公司将保持持续关注。感谢您的提问。</p> <p>34. 请问贵司的碳化硅芯片，目前的市场需求和产能情况如何？是不是处于供不应求的状态？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司的碳化硅产品全部为SiC MOSFET及模组，产品主要应用于车载主驱逆变器等，目前处于满产状态，市场需求旺盛。感谢您的关注。</p> <p>35. 贵司官网关于设立芯联动力，宁德晨道资本表示，“贵司SIC器件及模组产品技术先进，属于全球第一梯队水平，也是目前国内唯一一家成熟使用在新能源汽车主驱的SIC供应商。” 请问贵司在碳化硅芯片方面，目前共规划了多少条产线，全部投产能达到多少产能？</p> <p>答:尊敬的投资者您好。公司2023年6英寸SiC MOSFET产能已达到5000片/月。2024年公司8英寸碳化硅试验线有望实现通线。感谢您的关注。</p> <p>36. “芯联集成已成为新能源产业核心芯片的支柱性力量，公司营收产生于新能源汽车和风光储等新能源工控方面的占比超过80%。” 在新能源汽车芯片领域，贵司目前确实是。请问，贵司在风光储充等新能源工控芯片方面，主要生产的具体芯片有哪些？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司在能源电力领域，无论是光伏发电、风力发电还是特高压输电、电能质量治理以及工业4.0、生活和交通方面都能够提供完整的、高可靠、高效率的核心模拟器件解决方案。新型电力系统是新型能源体系的重要组成部分和实现双碳目标的关键载体。公司积极布局新型电力系统，目前公司的功率器件覆盖成12V-6500V，包含中低压和超结MOS、IGBT、SIC MOS等。在高压输配电领域，4500伏IGBT已成功挂网应用，实现了电网高压核心芯片的进口替代。工商业光伏模块产品也在海内外项目上大量装机。感谢您的关注。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年03月27日